



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100506000
2010 年 5 月 18 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA(ハイパフォーマンシアナログ) PCM1801U製品 モールド樹脂変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	■Initial notice (Plan)	□Final notice
変更概要	Design/Specification	□Design □Electrical □Mechanical
	Wafer Fab	□Site □Process □Material
	Wafer Bump	□Site □Process □Material
	■Assembly	□Site □Process ■Material
	Test	□Site □Process
	Others	□Packing/Shipping/Labeling □ -
変更内容	HPA(ハイパフォーマンシアナログ) PCM1801U 製品 モールド樹脂変更 現行：モールド樹脂 部材型番: 4205694 変更後：モールド樹脂 部材型番: 4209640	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	8 月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	■計画	□終了
製品表示	■変更無し	□変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本 PCN の更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の 90 日以降に予定いたしております。弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-Malaysia(マレーシア)サイト製造 PCM1801U 製品のモールド樹脂について、現行 部材型番：4205694 を使用して製造していますが、供給能力確保の為に、部材型番：4209640 に変更する予定です。部材型番：4209640 のモールド樹脂を使用した SOIC パッケージ製品は、TI-Malaysia サイトにおいて、2008 年 6 月 16 日に認定されています。下記信頼性試験結果を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

モールド樹脂 (部材型番)

現行

4205694

変更後

4209640

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名			
PCM1801U	PCM1801U/2K	PCM1801U/2KG4	PCM1801UG4

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2010 年 5 月	終了	2010 年 7 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	PCM1801U	Die Size (mm):	2.27 X 3.85	
Passivation:	SiO2/ Si3N4	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	1.2 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Char.	To datasheet parameters	30	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	82	82	82
ESD-CDM	500V	15	-	-
Visual / Mechanical	-	per spec	per spec	per spec
Lead Pull	# of leads to destruction	22	22	22
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5	5	5
Ball Bond Shear	5 units, >76 balls, 0 fails	76	76	76
Bond Pull	5 units, >76 balls, 0 fails	76	76	76
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1 /260C	12	12	12
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -1 /260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA211ID	Die Size (mm):	1.253998 X 0.970026	
Passivation:	TEOS & Nitride	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size/ Fails
**Autoclave	For MSL Eval, 121C, 96 Hrs			77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 Cycles			77/0
Manufacturability Qual	-			Approved
Delta Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C w/ CSAM deltas for pre to post reflow			22/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -2 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2277U	Die Size (mm):	2.032 X 3.175	
Passivation:	5kASiO2/8kASiON	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	1.2 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size/ Fails
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs (Deltas)			116/0
Electrical Characterization	PDS Limit Verification over temp range			30/0
High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs			77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs			77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs			77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 Cycles			77/0
ESD-CDM	500V			3/0
Visual / Mechanical	-			60/0
Lead Pull	To destruction			22/0
Flammability	Method A - UL94-0			5/0
Flammability	Method B - IEC 695-2-2			5/0
Flammability	Method C - UL 1694			5/0
Manufacturability	Per mfg site specification			Approved
**Thermal Shock	65C/150C, 1000 Cycles			77/0
X-ray	top side only			5/0
Delta MSL Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C w/ CSAM deltas for pre to post reflow			22/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -3 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA376AID	Die Size (mm):	0.9144 X 1.1176	
Passivation:	8kASiON	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size/ Fails
**Autoclave		For MSL Eval, 121C, 96 Hrs		77/0
**Temperature Cycle		-65C/150C, 1000 Cycles		77/0
Manufacturability		Per mfg site specification		Approved
Delta Moisture Sensitivity		JEDEC L-2 /260C		22/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -2 /260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA4241UA	Die Size (mm):	2.286 X 6.604	
Passivation:	5kASiO2/8kASiON	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	1.2 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size/ Fails
**Autoclave		For MSL Eval, 121C, 96 Hrs		77/0
**Temperature Cycle		-65C/150C, 1000 Cycles		77/0
Manufacturability		Per mfg site specification		Approved
Delta Moisture Sensitivity (Deltas & CSAM)		JEDEC L-3 /260C		22/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -3 /260C				